



QUICK 855T+

自动预热平台

使用 说明

快克智能装备股份有限公司
地址 (ADD): 江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路 11 号
电话 (TEL): 0519-86225678
传真 (FAX): 86-519-86558599
邮编 (POSTCODE): 213167
<http://www.quick-global.com>

感谢您购买此款预热自动平台, 使用前请仔细阅读本说明书, 阅读后请妥为保管, 以便日后查阅。

目 录

安全说明.....	1
1. 产品规格.....	2
2. 产品特点.....	2
3. 装箱部件.....	3
4. 产品图示.....	3
5. 操作方法.....	4
5.1 加热功能.....	4
5.2 温度调整方式.....	5
5.2.1 温度的常规设定.....	5
5.2.2 温度实时设定.....	6
5.3 设置温度与 PCB 预热温度比较.....	7
5.4 升降臂的调节.....	7
5.5 855T 和拆焊系统的操作方法.....	7
6. 显示视窗符号说明.....	9

安全说明

警告

1. 产品使用前，请确认产品电压与使用之电源电压是符合的。
2. 将产品放置于安全的工作台上，桌面应放置防火抗热橡胶垫。
3. 产品使用时须远离易燃物品如酒精，油漆，塑胶，纸张及木材等。
4. 产品属高温特性，必须放置于安全且小孩不易接触的场所。
5. 更换发热体元件或检修故障时，应等待发热体元件完全冷却后再作处理。
6. 切勿用于除预热 PCB 拆焊 IC 元件、BGA 植球等以外的工作，以免造成意外。
7. 勿让不了解产品特性者操作此产品，以免造成不必要的危险与损坏。
8. 长期不使用时，请将电源线插头拔除。



当心电击危险

1. 必须使用三芯接地插座，确认产品使用的 AC 电源有接地装置，以避免漏电危险。
2. 不可压放任何物品在电源线上，以免线皮损伤造成触电危险。
3. 避免加热视窗撞击或加热视窗表面渗入液体（如水或酒精等），以免造成龟裂、损坏、触电及火灾等。
4. 检查或维修时，请将产品电源开关关闭及拔除电源线插头。

六、显示视窗符号说明

1. 温度计视窗显示“— — —”，表示：a) 温度计传感器没有连接；b) 传感器开路；c) 所测试温度超过 600℃。
2. 温度控制显示窗显示“S - E”，表示预热台的传感器有问题，需要更换检测发热体的传感器。
3. 当工作时，显示温度小于 50℃，并不再升温，表示预热台的发热体可能损坏，需要检修或更换发热体。
4. 温度控制显示窗最末位元小数点为加热指示，点亮表示没有达到设置温度，灭表示超过设置温度，闪亮表示达到设置温度。

一、产品规格

加热功率：	1600W
加热区面积：	260mmx260mm
升降臂行程：	70mm (max)
加热体材料：	陶瓷发热体
温度传感器：	K 型热电偶
底部预热温度：	50℃~350℃
温度稳定度：	±1℃
环境温度：	0~40℃
温度计测量范围：	室温~600℃
温度精确度：	+/-5℃
重量：	约 13.3kg(不包括支架)

二、产品特点

1. 双工位设计，升降臂的位置可灵活调整。
2. 红外陶瓷加热体，加热快、效率高、寿命长。
3. 温度控制采用 K 型热电偶，闭合回路过零触发控制，数码管显示，操作简单直观。
4. 升降臂的机械运动采用粗调和微调相结合，控制自如；并可与 QUICK855PG 热风拆焊台配合使用。
5. 所需加热物体可方便放置于预热平台或支架上。
6. 使用两只开关分别控制电源及加热，在不加热的情况下，也能方便地观察到预热台上的温度。
7. 内置温度计，能方便检测 PCB 上的温度。
8. 适用于需预热以利拆卸零件的 PCB，如 IC 组件拆焊、BGA 植球等。

三、装箱部件

部件	数量
主机	1 套
简易支架	1 套
冷却风扇	1 台
支撑臂（2 个）和螺丝	1 套
连接线（六芯插头）	1
电源线	2
说明书	1
保修卡	1

四、产品图示



5.2), 芯片的热风拆、焊温度在所配的拆焊系统中设定(参照拆焊系统的使用说明书)。

5. 通过调节位置调节旋钮, 可以调节喷嘴向下移动的距离。
6. 通过 855T 预热自动平台控制工作:
 - 1) 按“START/STOP”键, 855T+开始工作, 升降臂向下移动, 到某一位置后触发拆焊系统开始工作。升降臂“△”或“▽”调节按键能起微调作用, 能够精确控制升降臂的位置。
 - 2) 在工作期间, 若按一下 855T+“START/STOP”键, 升降臂向上移动 5~10mm, 表示进入冷却状态, 此时, 触发拆焊系统进入冷却阶段, 开始吹冷风冷却。
 - 3) 若再按一下 855T+“START/STOP”键, 升降臂向上移动到顶, 触发 855PG 停止工作, 进入休眠状态。
7. 通过 855PG 可程序设计拆焊系统也可控制 855PG 和 855T 一起工作。

如:

- 1) 按下 855PG “START” 按键, 855T 升降臂开始向下移动, 在升降臂移动到位后, 855PG 按照选定的通道开始工作。
- 2) 若按一下 855PG “STOP” 键, 升降臂向上移动, 855PG 进入第六工作段, 开始冷却。
- 3) 若再按一下 855PG “STOP” 键, 升降臂向上移动到顶, 855PG 停止工作, 进入休眠状态。

注: 855PG 为选配件, 需另行订购。

5.6 升降臂的组装与拆卸

1. 从包装中取出升降臂, 长短各一个, 将短升降臂套在预热平台的升降轴上, 然后安装长的升降臂。
2. 将垫圈安装在长的升降臂上, 用升降臂固定螺丝固定住升降臂。
3. 在安装时, 可以根据需要调节升降臂的位置。通常, 短升降臂位于机器的右侧, 长升降臂位于机器的左侧。但短升降臂必须位于长升降臂的下面。

5.3 设置温度与 PCB 预热温度比较

本产品除适用于 IC 元件拆焊、BGA 植球外；凡需预热以利拆卸零件的 PCB，皆可应用本装置。但适用温度须依工作物的特性，应先作测试记录再应用。

序号	温度控制显示窗 (TEMP) 显示温度	放置于网架上的 PCB 温度测试值 (距离发热体 10mm)	放置于配置架上的 PCB 温度测试值 (距离发热体 55mm)
1	50°C	43°C	32°C
2	100°C	73°C	58°C
3	150°C	113°C	88°C
4	200°C	158°C	115°C
5	250°C	200°C	145°C
6	300°C	250°C	175°C
7	350°C	298°C	205°C

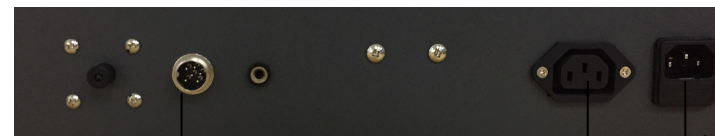
注：本测试值为室温 20°C 时所测，仅作参考，希望使用者先做测试记录再应用。

5.4 升降臂的调节

1. 在位置调节旋钮定位的以上位置，按升降臂调节按键“△”或“▽”将使升降臂快速向上或向下运动。
2. 在位置调节旋钮定位的以下位置，若按一下调节按键“△”或“▽”后松开，升降臂点动（微调）；若按住调节按键不松开，升降臂将缓慢连续向上或向下，直至所需位置后松开。

5.5 855T+和拆焊系统的操作方法

1. 将六芯连接线的一端和 855T+ 连接，另一端连接至可控的拆焊系统。
2. 连接好电源线，导通设备电源，升降臂向上移动、复位。
3. 旋开 855T+ 手柄固定夹上的锁紧螺母，将拆焊系统的手柄放置在 855T+ 手柄固定夹中，调整好手柄位置，然后将锁紧螺母都锁紧。
4. 调整好 PCB 上芯片和手柄喷嘴的位置，设定好 PCB 的预热温度（参照



可以与 855PG 或 856AD 连机

电源输出 电源输入

- | | |
|----------------|----------------------|
| 温度控制开关： | 控制预热台的温度 |
| 升降臂调节按键： | 控制升降臂的粗调和微调 |
| 位置调节选钮： | 控制喷嘴的位置 |
| START/STOP 按键： | 控制升降臂的工作、复 |
| 固定夹： | 固定风枪手柄 |
| 锁紧螺母： | 锁定固定夹 |
| 电源插座输入端： | 给 855T 提供电源 |
| 电源插座输出端： | 给外置冷却风扇提供电源 |
| 六芯插座： | 可以与 855PG 或 856AD 连机 |

五、855T+操作方法

5.1 加热功能

1. 根据需要放置好设备，连接好各部件连接线。
2. 把电源插头插入与预热台标贴值一致的电源座中。
3. 打开电源开关。
4. 温度控制显示窗 (TEMP) 显示设定温度约 2 秒钟，之后温度控制显示窗显示预热板上温度。温度可调范围：50°C ~ 350°C。
5. 如要改变设定温度（参考“5.2 温度调整方式”），可调整面板上温度控制显示窗的“▲”或“▼”按键。打开加热开关至 WARM 位置，设备开始加热，数分钟之后，温度达到设定值。
6. 待温度稳定后，把所要加热的 PCB 置于预热台加热窗口的上方（金属网罩上或支架上）。
7. 加热工作完毕，请随即关闭加热开关（COOL 位置）。打开冷却风扇开关，开始吹冷风冷却。

8. 工作完毕, 请随即关闭电源开关, 如长期不用, 请将电源线插头拔除。
9. 如若使用预热台自带的温度计检测温度 (如 PCB 的温度), 预热台必须提前 15 分钟连接 K 型传感器后才能测试。



注意:

1. K 型传感器有正负极性, 连接时切勿插反。如若测高温时温度计显示数位不升高, 则需检查传感器接外挂程序有无接反。
2. K 型传感器必须插到底, 连接可靠。



警告:

1. 工作中, 预热台加热视窗及周围温度很高, 小心烫伤。
2. 工作中应避免细小的物件掉入机器内, 如有对象掉入机器内, 请务必切断电源, 待发热体冷却后把掉入机器内部的物件取出。

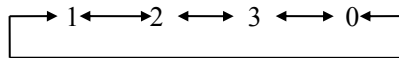
5.2 温度调整方式

温度的设定有两种方式, 常规设定和实时设定。

5.2.1 温度的常规设定

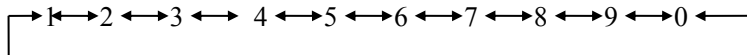
长按 “*” 键

1. 首先显示预设温度, 然后百位元数位开始闪烁, 表示已进入温度设定模式, 此时, 可以设定百位元数位。
2. 按 “▲” 或 “▼” 按键设定百位元数位, 显示数位变换次序如下图所示:



当显示所需数位时, 即按下*键。中间十位数开始闪烁, 表示十位数可以设定。

3. 按 “▲” 或 “▼” 按键设定十位元数位, 显示数位变换次序如下图所示:



按下 “*” 键。右边个位数开始闪烁, 表示个位数可以设定。

4. 按 “▲” 或 “▼” 按键设定个位元数位, 个位元数位的设定和显示数位变换次序同十位元数。
5. 设置完后, 按 “*” 键。
 - a) 将所设定温度输入内部记忆。
 - b) 显示所设定温度。
 - c) 加热器开始工作, 直至温度稳定。

- 注:**
- * 如果在设定温度时电源断开, 所设数值将不存入存储器。
 - * 如果按 “*” 键不到 1 秒钟, 现存的设定温度将显示两秒钟, 然后显示预热板上温度。按下 “*” 时发热体电源断开。
 - * 当设定温度值超过温度设定范围, 百位数将再次闪亮, 发生这种情况时, 请再输入正确的温度值。

5.2.2 温度实时设定

若需在工作中不断开加热体电源的情况下, 快速设置温度, 则应按照 “温度实时设定” 方法设定加热温度。

升温: 不按 “*” 键, 直接按 “▲” 键, 则设定温度上升 1℃, 温度控制显示视窗显示设定温度, 释放 “▲” 键后, 显示视窗延时显示设定温度约 2 秒; 若在延时 2 秒内再按此键, 则设定温度上升 1℃; 若长按 “▲” 键, 则设定温度快速上升, 直到所需设定温度时释放 “▲” 键。

降温: 不按 “*” 键, 直接按 “▼” 键, 则设定温度下降 1℃, 温度控制显示视窗显示设定温度, 释放 “▼” 键后, 显示视窗延时显示设定温度约 2S, 若在延时 2S 内再按 “▼”; 则设定温度快速下降 1℃, 若长按 “▼” 键, 则设定温度快速下降, 直到所需设定温度时释放 “▼” 键。